

中信建投证券股份有限公司
关于北京燕东微电子股份有限公司
2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：北京燕东微电子股份有限公司
保荐代表人姓名：张林	联系方式：010-56051430 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦-中信建投证券 11 层
保荐代表人姓名：侯顺	联系方式：010-65608236 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦-中信建投证券 11 层

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）“证监许可（2022）2575 号文”批准，北京燕东微电子股份有限公司（简称“公司”或“燕东微”），同意燕东微首次公开发行股票的注册申请。本次公司发行新股的发行价为 21.98 元/股，募集资金总额为 395,344.63 万元，扣除发行费用 19,693.29 万元后，实际募集资金净额为 375,651.34 万元。本次公开发行股票于 2022 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次公开发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。

一、持续督导工作情况

	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构与燕东微签订持续督导相关协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务

	工作内容	持续督导情况
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解燕东微经营情况，对燕东微开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2024年上半年燕东微在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等。	2024年上半年燕东微在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	在持续督导期间，保荐机构督导燕东微及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促燕东微依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对燕东微内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，燕东微的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促燕东微严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补	保荐机构对燕东微的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

	工作内容	持续督导情况
	充的，应及时向上海证券交易所报告。 对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2024 年上半年燕东微及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年燕东微及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2024 年上半年，经保荐机构核查，燕东微不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2024年上半年，燕东微未发生相关情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计 划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。上市公司出现以下	2024 年上半年，燕东微不存在需要专项现场检查的情形

	工作内容	持续督导情况
	情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所要求的其他情形。	
16	持续关注上市公司的承诺履行情况。	2024 年上半年，燕东微不存在未履行承诺的情况

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐机构和保荐代表人未发现燕东微存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

1、产品研发与技术迭代风险

半导体行业具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点，产品业务新的应用场景不断涌现；代工客户需求更新迭代非常迅速，且产品品种较多；公司需要根据市场需求不断优化产品设计，升级产品制造工艺，提升产品性能和质量管控水平。如果公司的技术与相关工艺未能进行推陈出新，可能导致公司产品被替代，对公司的持续竞争力产生不利影响。

2、研发不及预期风险

由于半导体行业产品、技术研发有着难度高、周期长、投入多、不确定性高等特点，若公司现有的研发不及预期，容易造成前期的投入无法转换成产品、没有新技术使用而使得产品落后于竞争对手，从而造成人力物力资源的浪费，影响

经营效益，从而影响公司的可持续发展。

3、关键技术人才流失的风险

半导体行业对技术人才的专业性及经验要求较高，具有技术密集型的特点。随着半导体行业快速发展，人才需求与日俱增，人才竞争加剧，若公司不能提供更好的发展平台、更有竞争力的薪酬待遇及良好的研发条件，仍存在关键技术人员流失的风险。

(二) 经营风险

1、行业周期性及公司经营业绩波动风险

半导体行业具有较强的周期性特征，公司业务的终端应用以消费电子领域为主。如果消费电子所处下游行业整体出现较大周期性波动，公司未能及时判断下游需求变化，或者受市场竞争格局变化等因素影响，可能导致公司出现产品售价下降、销售量降低等不利情形，公司收入持续增长存在不确定性风险。

2、客户集中度较高的风险

公司客户相对集中，如果未来公司主要客户经营状况发生重大不利变化、采购需求下降或调整采购策略，可能导致公司订单下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

3、主要原材料供应商集中度较高及原材料供应风险

公司生产依赖于多种原材料，包括各种硅片，气体，化学品等，原材料的及时供应是保证公司稳定生产的必要条件。如果未来公司主要供应商因产能紧张，或者由于国际政治及其他不可抗力等因素，出现延迟交货、提高价格或者停止向公司供货的情况，将导致公司短期内材料供应紧张或成本上升，从而对公司盈利能力产生不利影响。

4、核心技术泄密风险

经过三十余年的发展与积累，公司形成了一定数量的发明专利和非专利技术，这些技术成为公司在市场竞争中取得成功的重要依托。如果公司核心技术被竞争对手窃取或抄袭，则可能产生核心技术泄密风险，导致公司产品与方案业务及制

造与服务业务的市场竞争力下降。

（三）财务风险

1、信用风险

公司主要客户均为长期合作、信用水平较高、应收账款回款良好的企业，且公司对应收账款余额进行持续监控，但如果市场环境发生不利变化、部分客户出现经营风险而不能按时回款，公司可能存在因坏账损失增加导致经营业绩下滑的风险。

2、存货风险

随着公司经营规模和经营业绩的不断扩大，期末存货余额可能会随之提高，如果公司存货管理不够科学，占用公司的营运资金，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

3、利率风险

公司负债率较低，由于市场利率变动的风险与公司借款相关，所以利率风险对公司影响较小。

4、流动性风险

为了满足公司日常经营需要，公司现金及现金等价物充足，并对其进行实时监控，因此公司所承担的流动风险较低，对公司的经营和财务报表不构成重大影响。

（四）行业风险

1、行业竞争风险

近年来，我国半导体产品市场需求不断扩大，推动半导体行业的快速发展，在国家大力支持的背景下，面临着良好的行业发展机遇，也吸引了众多国内外企业的进入，竞争日益激烈。如果公司不能把握市场行业发展规律、持续研发创新并提升生产管理效率，不断优化产品设计，可能导致公司跟不上竞争对手新技术、新工艺的持续升级，产品失去竞争力，对公司的持续盈利能力产生不利影响。

2、产业政策变化风险

近年来,国民经济发展的推动下,半导体行业获得了国家一系列政策的支持。我国半导体行业整体的设计能力、生产工艺、自主创新能力有了较大的提升。如果未来国家相关产业政策支持力度减弱,可能导致下游市场需求下降、政府补助和税收优惠减少等不利情形,公司的持续盈利能力及成长性可能受到不利影响。

(五) 宏观环境风险

1、宏观经济波动风险

半导体行业与宏观经济和政治环境密切相关,受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响,如果宏观经济波动较大或长期处于低谷,下游市场需求的波动和低迷导致集成电路产品的需求下降,或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况,导致产能供应在景气度较低时超过市场需求,进而影响公司集成电路晶圆代工的盈利能力,可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

2、汇率波动的风险

受政治、经济形势的变化以及中国外汇政策等因素的影响,人民币与美元及其他货币的汇率存在波动,公司难以预测市场、金融政策等因素未来可能对人民币与美元汇率产生的影响,可能对公司的流动性和现金流造成不利影响。

3、国际贸易摩擦风险

由于国际贸易政策存在一定的不确定性。如果全球贸易摩擦加剧,境外客户可能会减少订单、要求公司产品降价或者承担相应关税等措施,境外供应商可能会被限制或被禁止向公司供货。若出现上述情况,则公司的经营可能会受到不利影响。

(六) 其他重大风险

1、控股股东、实际控制人控制的风险

公司控股股东及实际控制人为北京电控,占公司全部股份的比例为 35.07%,北京电控通过下属单位并通过一致行动人合计控制公司 51.19%的股份。如果北京电控利用其控股地位行使表决权对公司的人事任免、经营决策施加重大影响,

可能会损害公司及其他股东的利益。

2、管理风险

公司上市后,资产规模有大幅的增长,未来公司在组织模式、管理制度建设、信息化系统完善等方面可能无法及时适应外部环境的快速变化,有可能造成公司管理效率降低,使得相应的成本和费用上升,进而影响公司的经营效率和经营业绩,为公司带来管理风险。

3、安全生产风险

公司拥有晶圆制造生产线和封装测试生产线,主要产品和服务的工艺复杂,在生产中会使用操作难度高的大型设备、部分易燃、有毒以及具有腐蚀性的材料等,具有一定的危险性,如果员工日常生产中未能严格按照操作标准使用相关设备及材料,可能会带来人员伤亡、财产损失、产线停工、行政处罚等安全生产风险。

四、重大违规事项

在本持续督导期间,燕东微不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年上半年,公司主要财务数据如下所示:

单位:元

主要会计数据	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增减(%)
营业收入	616,709,361.77	1,083,929,269.40	-43.10
归属于上市公司股东的净利润	-15,133,992.94	267,528,281.84	-105.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,542,986.93	208,624,928.21	-135.25
经营活动产生的现金流量净额	198,860,439.37	172,546,845.84	15.25
主要会计数据	2024年6月末	2023年度末	本期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股	14,798,005,477.97	14,859,119,796.56	-0.41

东的净资产			
总资产	18,224,709,318.04	18,484,430,578.71	-1.41

公司主要财务指标如下表所示：

主要财务指标	2024年1-6月	2023年1-6月	本期比上年同期增 减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.22	-104.55
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.22	-104.55
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元/股)	-0.06	0.17	-135.29
加权平均净资产收益率 (%)	-0.10	1.85	减少1.95个百分点
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-0.50	1.44	减少1.94个百分点
研发投入占营业收入的 比例(%)	18.38	8.72	增加9.66个百分点

2024年上半年，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

(一) 营业收入同比下降 43.10%，主要系市场发生变化，部分产品价格下降及需求下滑所致；

(二) 归属于上市公司股东的净利润同比下降 105.66%，主要系市场发生变化，部分产品价格下降及需求下滑所致；

(三) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 135.25%，主要系市场发生变化，部分产品价格下降及需求下滑所致；

(四) 经营活动产生的现金流量净额同比上升 15.25%，主要系本期销售回款有所上升以及收到增值税留抵税额退税、政府补助金额较同期上升；

(五) 归属于上市公司股东的净资产和总资产较期初分别下降 0.41%、1.41%，主要系本期留存收益下降所致；

(六) 基本每股收益以及稀释每股收益较上年同期下降 104.55%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润同比下降；

(七) 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降 135.29%，主要系本期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润同比下降。

六、核心竞争力的变化情况

（一）集设计、制造和封测于一体的全产业链运营能力

公司以“成为卓越的集成电路制造和系统方案提供商”为愿景，初步完成“6+8+12”英寸晶圆产线布局，坚持 More than Moore 和特色工艺融合发展方向，走 IDM+Foundry 的发展路线。公司经过三十余年的发展与积累，形成了具有自身特色的集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的 IDM 运营模式，同时，公司注重特色工艺开发，可灵活快速支持企业持续完善产品性能、拓展产品功能，提升产品竞争力。此外，公司长期以来形成的 IDM 运营模式，有助于增强企业抵御市场波动的能力及保持生产的稳定运营。

（二）特种集成电路及器件产品持续丰富，客户长期稳定

公司持续丰富特种集成电路及器件种类，混合集成电路产品新增了为用户定制开发的专用预处理模块系列；功率器件拓展了硅基射频 LDMOS 和 VDMOS 的部分产品；光电器件完成了光电耦合器系列产品中的发光芯片的国产化研制，在特种集成电路及器件工艺技术方面，研发的高可靠高压 CMOS SOI 工艺，具有天然免疫闩锁、抗过电应力能力强，可靠性高等特点；混合集成电路用的高精密金属膜电阻制备的薄膜工艺目前可达 10PPM 精度水平。基于持续丰富的产品系列以及不断提升的工艺技术能力，特种产品应用市场稳定。

（三）制造与服务能力大幅提升，核心竞争力显著增强

在工艺平台建设方面，基于 6 英寸、8 英寸、12 英寸晶圆生产线，聚焦功率半导体、光电子、传感器、ASIC 四大产品方向，实现了以下工艺平台的建设及拓展：

（1）12 英寸晶圆生产线高密度功率器件完成了客户的可靠性认证，实现了稳定量产，良率达到 98.5%以上；

（2）8 英寸晶圆生产线 IGBT 和 FRD 等工艺平台产品通过了国内新能源汽车头部企业的可靠性认证并实现批量供货；标准 CMOS 工业用显示驱动电路通过客户验证；HV CMOS 低边 MOSFET 栅极驱动完成样品研制；基于超高压 600V BCD 工艺平台基础上实现 13 款产品规模化量产；

(3)1200V SiC SBD 产品通过客户样品验证,目前产品良率达到 95%以上; 1200V SiC MOS 器件产品完成了样品试制并通过了可靠性试验;

(4) SiN 硅光工艺平台实现关键突破,开发了 5 款新产品并转入量产实现稳定供货,产品良率达 95%以上,应用于激光雷达以及光通信领域。

公司 8 英寸相关硅光产品已实现市场化销售,12 英寸已完成硅光关键工艺开发。

(四) 完善的质量管理体系和稳定的客户资源

公司高度重视产品从研发到交付各环节的质量控制,公司已通过 ISO14001、ISO45001、ISO9001、IATF16949 等体系认证,逐步建立起了完整的质量管理体系,并参与多项国家电子行业标准的制定。公司拥有完备的可靠性实验室和产品异常解析实验装置,对产品进行可靠性认证及产品的异常失效分析,以期能更好地保障产品质量。公司始终秉承质量第一、客户至上的经营理念,在多个细分领域推出了品质优异、性能稳定的系列化产品,在满足了客户需求,获得了市场认可的同时,积累了大量稳固的客户资源。

七、研发支出变化及研发进展

(一) 报告期内获得的研发成果

(1) 12 英寸晶圆生产线高密度功率器件具备批量稳定量产能力,良率达到 98.5%以上;

(2) 基于 8 英寸、12 英寸晶圆生产线持续提升高密度功率器件沟槽图形化工艺能力,比导通电阻性能提升 10%以上,导通电阻达到业内先进水平;

(3) 车规级 IGBT 工艺平台实现批量生产;

(4) 基于超高压 700V BCD 工艺平台基础,实现 22 款产品规模化量产;

(5) 基于 8 英寸晶圆生产线,完成 CMOS 工业用电机驱动电路量产;

(6)1200V SiC SBD 产品完成技术迭代,功率密度达到国内先进水平;1200V SiC MOS 产品完成关键工艺优化,导通电阻、漏电流等主要参数达到行业主流产

品水平；

(7) 基于现有 SiN 硅光工艺平台，完成 5 款新产品研制，转入量产实现稳定供货；

(8) 完成通用逻辑系列产品量产交付；32 通道总线收发器产品通过客户验证；

(9) 完成 5V/40V SOI CMOS 工艺平台搭建，代表产品通过可靠性认证；

(10) 在射频领域拓展方面，完成 13.56MHz 射频电源千瓦级产品的研制，实现量产交付。

(二) 报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	13	8	161	85
实用新型专利	15	13	317	309
外观设计专利	0	0	0	5
软件著作权	0	0	19	18
集成电路布图	0	0	43	46
商标	0	0	21	11
合计	28	21	561	474

(三) 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	113,326,255.02	94,558,474.28	19.85
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	113,326,255.02	94,558,474.28	19.85
研发投入总额占营业收入比例 (%)	18.38	8.72	增加 9.66 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金专项账户净额	3,756,513,376.97
截至 2024 年 6 月 30 日累计投入募集资金总额	3,587,537,327.11
（1）募集资金投资项目投入	1,345,787,604.84
（2）募集资金投资项目先期投入及置换	1,653,955,722.27
（3）补充流动资金	587,794,000.00
加：累计利息收入（减手续费）	56,035,971.02
其中：本年度利息收入（减手续费）	21,678,099.15
募集资金应有结余	225,012,020.88
（1）募集资金专项账户期末余额	75,012,020.88
（2）用于现金管理尚未到期金额	150,000,000.00

募集资金具体使用情况详见募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目前期投入及置换情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的人民币 165,395.57 万元及以募集资金置换已支付发行费用的人民币 34.24 万元。该事项已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华【2023】001140 号《关于北京燕东微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。独立董事、保荐机构及会计师事务所均发表了明确的同意意见。

（三）对闲置募集资金进行现金管理

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的明细如下：

所属公司	受托人	产品名称	认购金额（元）	起息日	到期日	是否已赎回
------	-----	------	---------	-----	-----	-------

燕东微	广发银行股份有限公司北京青年路支行	结构性存款	150,000,000.00	2024-5-17	2024-8-21	否
合计			150,000,000.00	-	-	-

(四) 募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日专户余额	存储方式
燕东微	北京银行酒仙桥支行	20000001447300105635177	1,500,000,000.00	18,638,571.80	活期
	中信银行北京分行营业部	8110701013702425768	1,500,000,000.00	16,747,401.18	活期
	广发银行股份有限公司北京青年路支行	9550880222605700419	771,438,546.97	35,733,558.10	活期
燕东科技	北京银行国际新城支行	20000035206700105761169		3,892,489.80	活期
合计			3,771,438,546.97	75,012,020.88	-

注：募集资金账户初始存放资金 3,771,438,546.97 元与募集资金净额 3,756,513,376.97 元存在差额，差异原因为发行费用中有 14,925,170.00 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年6月30日

单位：元

募集资金总额				3,756,513,376.97		本年度投入募集资金总额				627,657,400.27		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				3,587,537,327.11		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于成套国产装备的特色工艺12吋集成电路生产线项目（以下简称“12吋项目”）	无	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	558,363,400.27	2,999,743,327.11	-256,672.89	99.99	一阶段：2023年4月试生产，2024年7月产品达产； 二阶段：2024年4月试生产，2025年7月项目达产。	不适用	是	否
补充流动资金	无	756,513,376.97	756,513,376.97	756,513,376.97	69,294,000.00	587,794,000.00	-168,719,376.97	77.70	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	3,756,513,376.97	3,756,513,376.97	3,756,513,376.97	627,657,400.27	3,587,537,327.11	-168,976,049.86	95.50	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不存在未达到计划进度的情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					在募集资金到位前，公司已预先利用自筹资金投入募投项目 详见（二）募投项目前期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见（三）对闲置募集资金进行现金管理							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

公司 2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京燕东微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



张 林



侯 顺

中信建投证券股份有限公司

